

M.2 SSD 散热模组

M.2 SSD Thermal Module

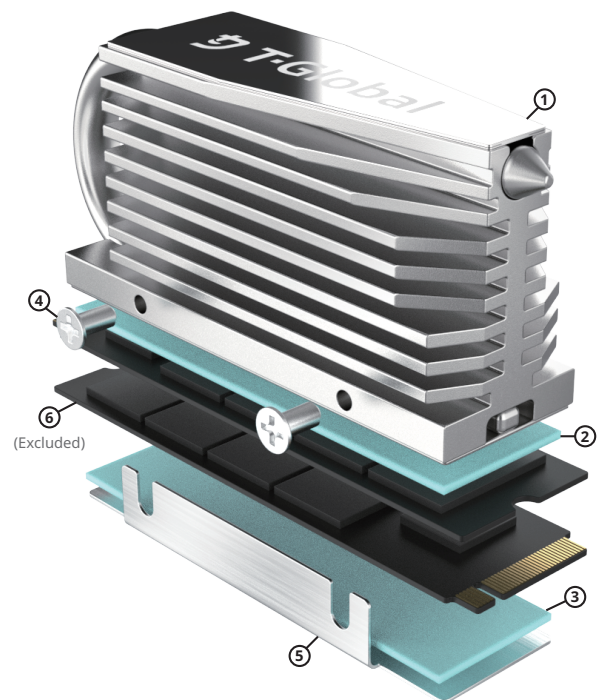
RoHS Compliant

支援类型 Supported Types

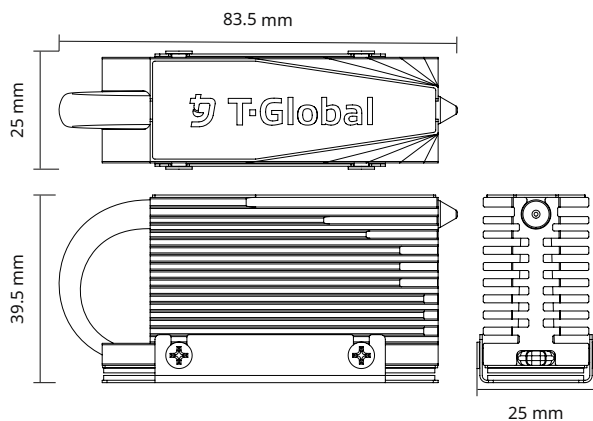
- NVME SSD
- NGFF SATA
- Intel SSD6/7
- Compatible with single sided/double sided M.2 2280 SSD
- Samsung 970 EVO/950Pro/960EVO/XP941/PM951/PM961 SM951/SM961
- Plextor M6e
- Kingston HyperX Predator M.2 SSD

产品规格 Specifications

Properties	Unit	M.2 SSD Thermal Module
散热片材质 Heatsink Material	-	铝合金 Aluminum Alloy
装置类型 Device Type	-	个人电脑内的散热片 Internal PC Heatsink
尺寸 Dimensions L x W x H	mm	83.5 x 25 x 39.5 mm ±1
重量 Weight	g	110
鳍片规格 Fin Specifications	mm	厚度 Thickness 1.7
	mm	间距 Spacing 1.7
鳍片数量 Number of Fins	pcs	18
导管直径 Catheter Diameter	mm	Ø6
工作温度 Operating Temperature	°C	0~+70
降温幅度 Cooling Range	°C	15~30
相容性 Compatibility	-	与 M.2 2280 SSD 相容 Compatible with M.2 2280 SSD
保固 Warranty	Year	2



- ① Heat Sink
- ② TG-A6200 Thermal Pad
- ③ TG-A6200 Thermal Pad
- ④ Screw x6
- ⑤ Metal Sheet
- ⑥ Solid State Disk (SSD) (Excluded)



安装说明 Installation Guide

组件上的螺丝全数取下准备进行安装
Remove all screws from the components, preparing for installation.

撕除两片导热硅胶片上的保护膜
Peel off the protective film from the two thermal pads.

金属板贴合于 SSD 背面 (无芯片的一侧)
Attach the metal sheet to the back of the SSD (the side without chips).

散热片贴合于 SSD 正面 (有芯片的一侧)
Attach the heat sink to the front of the SSD (the side with chips).

螺丝锁上固定散热片与金属板
Tighten the screws to secure the heat sink and metal sheet.

插入主机板的 M.2 插槽并用螺丝固定
Insert the assembly into the M.2 slot on the motherboard and secure it with screws.

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
 T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20
20250211



注意：本技术数据表内的资讯是根据高柏团队的研究与测试得出的最佳数据。本技术数据表中列出的值仅代表典型值，并非对每一批生产的物料都进行测试。所有规格如有变更，恕不另行通知；无影响产品功能之保护膜及离型纸，若非特殊要求，皆依高柏默认为准。由于各种可能的使用条件超出了我们的控制范围，因此我们提出的所有建议均不构成保证或责任，用户应自行进行测试，以确定我们的产品在任何特定情况下的适用性。本产品的销售没有任何明示或暗示的说明，表示其适用于特定目的或其他用途的保证，但本产品应依据高柏与您确认的发票、报价、或订单，提供最标准的产品质量。我们不承担使用者如何延伸或改变此技术数据表中的资讯，使用者应承担所有风险。此外，本技术数据表中的资讯不包含任何内容解释与涉及产品材料的现有用途、未来专利冲突、工艺制造，与使用产品的建议。